

USB3.1C S1V DN4 RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Informations générales de commande**

Version	Données OMNIMATE - Prise USB, Connecteur pour circuit imprimé, Type C, 10 Gbit/s, Raccordement soudé SMD, 180°, Cycles d'enfichage: ≥ 10000, Pas en mm (P): 0.50, Nombre de pôles: 24, LCP, Bobine
Référence	3100390000
Type	USB3.1C S1V DN4 RL
GTIN (EAN)	4099987137645
Qté.	1 000 pièce(s)
Emballage	Bobine

Date de création 14 mai 2025 11:20:54 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	4,3 mm	Profondeur (pouces)	0,169 inch
Hauteur	9,25 mm	Hauteur (pouces)	0,364 inch
Largeur	8,94 mm	Largeur (pouces)	0,352 inch
Poids net	10 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01
ECLASS 14.0	27-46-02-01	ECLASS 15.0	27-46-02-01

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - contact	750 V AC	Tension nominale	5 V
Tenue d'isolation	≥ 100 MΩ		

Caractéristiques du système

Angle de sortie	180°	Blindage	Oui
Catégorie de puissance	10 Gbit/s	Cycles d'enfichage	≥ 10000
Degré de protection	IP20	Famille de produits	Données OMNIMATE - Prise USB
Fermeture latérale, propriété	Brides à souder	LED	Non
Languettes de blindage	aucun	Longueur du picot à souder (l)	1,15 mm
Matériau de blindage	Laiton	Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé SMD
Nombre de picots par pôle	1	Nombre de pôles	24
Pas en mm (P)	0,5 mm	Surface de blindage	nickelé
Système de soudure	Soudure par refusion, Soudure manuelle	Type de raccordement	Femelle
Vitesse de transmission	10 Gbit/s		

Données des matériaux

Matériau isolant	LCP	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Tenue d'isolation	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du contact	Alliage de cuivre	Matériau des contacts	Alliage phosphore/bronze
Surface du contact	Or sur nickel	Température de fonctionnement, min.	-30 °C
Température de fonctionnement, max.	80 °C		

Emballage

Emballage	Bobine	Longueur VPE	0 mm
Largeur VPE	0 mm	Hauteur VPE	0 mm

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Fiche de données**USB3.1C S1V DN4 RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS

Conforme

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

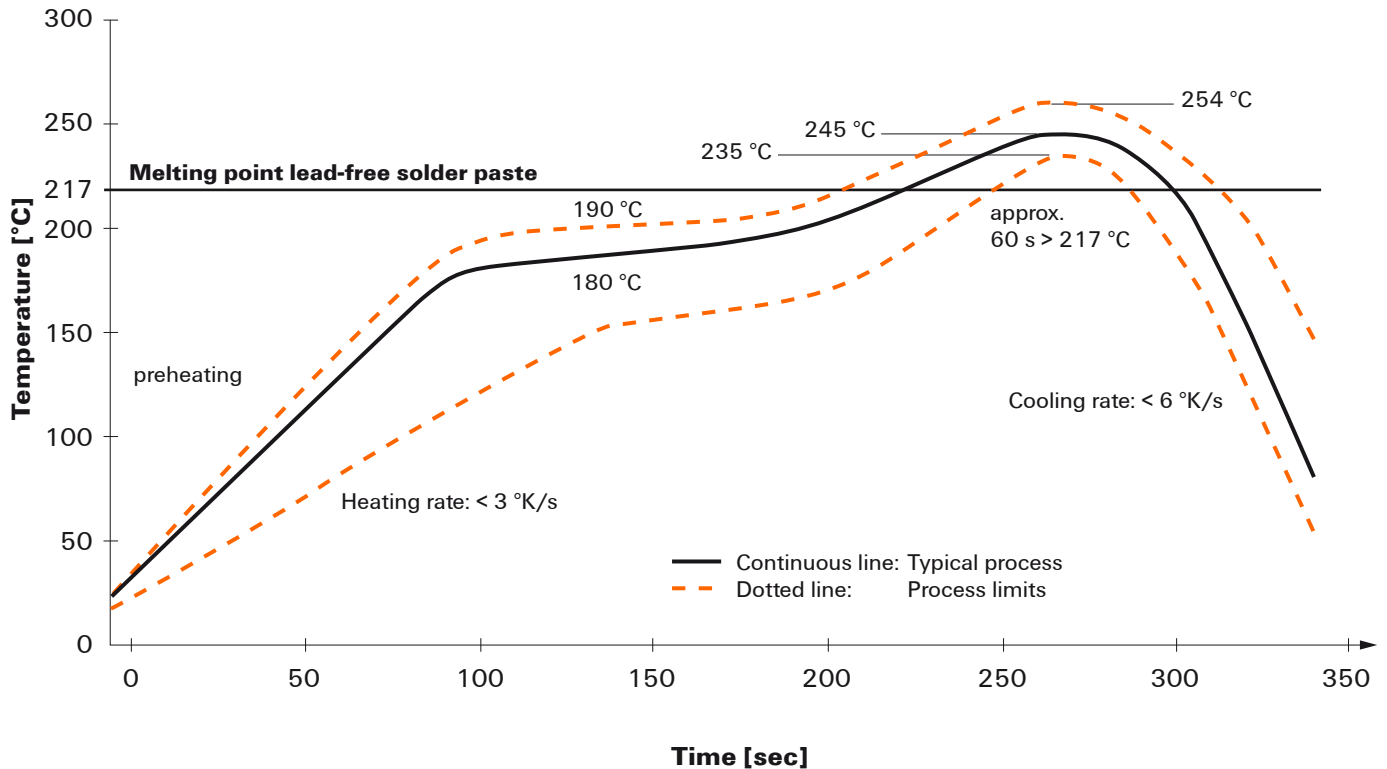
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.